

广州方邦电子股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高广州方邦电子股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展质效，增强投资者回报，推动公司高质量发展和投资价值提升，公司将积极采取各项措施推动开展“提质增效重回报”专项行动。主要内容如下：

一、聚焦主营业务，推动公司经营业绩逐步向好

公司自上市以来，持续进行高强度研发投入，取得良好成效，目前产品除拥有电磁屏蔽膜外，还依托真空镀膜、电化学、精密涂布以及配方合成等四大平台技术陆续开发了带载体可剥离超薄铜箔（可剥铜）、挠性覆铜板（FCCL）、电阻薄膜、复合铜箔以及标准电子铜箔等产品，逐步成长为稀缺高端电子材料平台型企业。

1、进一步加快、加大各产品下游认证进度及市场开拓力度

对于“老产品”电磁屏蔽膜，2024 年力争实现销售量 400 万平方米以上，同比增长 17% 以上，进一步巩固、提升公司的市场占有率和行业领先地位。依托优秀的产品性能，巩固并稳步提升当前收入利润规模；同时密切关注新客户、新领域的技术发展趋势，如柔性屏蔽罩、折叠屏手机要求电磁屏蔽膜更薄、更耐弯折，AI 手机的高算力性能引发手机内部明显的散热问题，要求电磁屏蔽膜在屏蔽功能的基础上承担部分散热功能等，持续迭代升级产品性能，以新产品、新解决方案缩短客户“等待期”，实现增量突破。

对于可剥铜，进一步提升产品良率和稳定性，总结、聚焦相关头部载板厂对产品技术及品控体系的认证要求和标准，举一反三，推进通过更多下游载板厂商的测试认证；同时联合相关终端积极推进可剥铜向手机芯片封装、手机主板 RCC 材料等应用场景的渗透，实现订单逐步爬坡。由于该产品为芯片封装材料，导入应用牵涉下游制程工艺、参数相关调整，认证严苛、流程长，2024 年力争实现近千万元级别订单销售额，在外企长期垄断的行业格局中逐步实现“从零到一”突破。

对于 FCCL，坚定推进原材料自研自产战略，充分利用 FCCL 与电磁屏蔽膜产品下游需求直接客户为同一客户群，均为 FPC 厂商，客户资源协同效应较大的特点，推进使用自产铜箔生产的 FCCL 产品于 2024 年上半年在中小规模软板厂商逐步铺开，不断积累产品制程数据和市场履历，以此为基础加快产品在中大规模软板厂商的推广导入工作，于 2024 年下半年实现订单逐步上量，争取全年实现销售量 20-30 万平方米，逐步成为公司业绩新增长极；使用自产铜箔+自产 PI/TPI 生产的 FCCL，有序开展下游测试认证工作。

对于薄膜电阻、复合铜箔，加快认证进度，推进通过更多下游认证，2024 年力争实现千万元级别订单销售，逐步实现量产突破，增厚公司业绩；同时密切关注电子产品芯片热管理、AI 服务器高速铜缆电磁屏蔽材料的前沿需求，加大热敏型薄膜电阻、电磁屏蔽用复合铜箔的开发及下游认证工作。

对于标准电子铜箔业务，持续提升良率，并根据市场情况动态调整产能投放及优化产品结构，大力推动 RTF 等产品的认证进度及订单落实，逐步改善铜箔业务盈利能力。

2、进一步拓展海外市场

产品出海，是公司一直坚持的战略规划，也是摆脱国内行业“内卷”的有效措施。2021-2023 年，公司海外业务分别实现收入 3394.21 万元、3582.37 万元和 4315.94 万元，海外业务开拓稳步推进。2024 年，公司将进一步加大海外市场开拓力度：一方面，通过“内外结合”方式加强与海外客户沟通对接。内部持续完善、强化海外业务由“董事长兼总经理主抓、核心技术人员和专业市场人员跟进落实”的常态化机制；外部积极整合行业资源，通过联合国内头部电路板厂商、参加行业国际性展会、峰会等方式，与海外客户开展对话、沟通，提升沟通有效

性和话语权。另一方面，以电磁屏蔽膜产品为切入口，向北美、韩国等头部客户一揽子推介、导入可剥铜、极薄 FCCL、高速铜缆电磁屏蔽用复合铜箔等高端电子材料。

二、以技术创新驱动发展，持续提升核心竞争力

公司致力于成为一家世界级的高端电子材料研发制造企业，始终把创新作为引领发展的第一动力。2021-2023 年，公司单年度研发投入占营业收入的比重维持在 16% 以上；截至 2023 年底，公司围绕电磁屏蔽膜、挠性覆铜板、超薄铜箔等领域在研项目累计投入 17192.09 万元，共获得专利 285 项，含发明专利 66 项，其中国内发明专利 38 项，美国、韩国和日本发明专利共 28 项。2024 年将继续坚持以市场和客户需求为导向，持续加大研发资金投入、加强高端研发人才引进与培养、加强研发制度体系建设，计划全年研发投入不低于 5000 万元，在核心技术、产品领域新增授权发明专利不低于 20 项，持续增强核心竞争力、构建新质生产力：

第一，不断夯实以真空溅射、连续卷状金属电沉积（电化学）、精密涂布以及各类材料配方合成等四大基础技术构成的核心技术平台，实现横向多技术协调组合创新、纵向单项技术深度延伸的良好研发局面，不断提升高端电子材料开发的底层能力。

第二，聚焦行业前沿，围绕折叠屏手机、AI 手机、智能眼镜、智能头显等高端应用场景，围绕电子产品轻薄化、芯片封装先进化、芯片主动热管理、电路板布线细微化等前沿确定性趋势，加强产品开发和升级迭代，2024 年公司将围绕柔性屏蔽罩，超薄、高耐弯折及散热电磁屏蔽膜，可剥铜与类 ABF 树脂结合形成 RCC/FRCC 材料，极薄介电层 FCCL 等重点项目加大研发投入，为公司未来发展奠定基础。

第三，加强高端研发人才引进、培养以及产学研合作。依托广东工业大学，完成博士后工作站分站搭建，年内引进 2-5 名博士后，进一步充实、优化公司研发队伍，有力促进公司相关底层技术提升；进一步加强与广东粤港澳大湾区国家纳米科技创新研究院、清华大学深圳国际研究生院、工业与信息化部电子第五研究所等高校院所的产学研合作，充分发挥高校院所的理论研究优势，结合公司的市场优势和产业化能力，加强承接国家、省级相关科研课题及项目，同时共探行

业前沿技术，拓宽技术边际、深挖技术纵深，持续增强公司核心技术创新能力，助力公司长期高质量发展。

三、重视股东回报，共享发展成果

1.利润分配

经综合考虑宏观经济环境、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，为更好传递公司对后续发展的坚定信心、更好回报中小投资者，在充分考虑日常经营及发展规划资金需求的前提下，公司于 2019 年度、2020 年度、2021 年度以及 2023 年年度分别派发现金红利 4000 万元、4000 万元、1500 万元和 1500 万元。未来公司将在符合《公司章程》规定利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分综合考虑行业发展情况、自身经营模式和盈利水平等因素，牢固树立回报股东意识，提振市场信心，继续建立稳定的回报机制，与股东共享公司经营发展成果。

2.股份回购

2023 年 10 月 31 日，公司披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益，同时完善公司长效激励机制，更紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司开展了以自有资金通过集中竞价交易方式回购部分股份。截至 2024 年 4 月回购已实施完毕，总计回购股份 430,733 股，回购金额 1500.51 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

3.实际控制人及董事、高管增持

2024 年 2 月 8 日，公司披露了《关于公司实际控制人及董事、高管增持股份计划暨公司“提质增效重回报”行动方案的公告》，公司实际控制人及部分董事、高级管理人员为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，基于对公司未来发展的信心及对公司长期投资价值的认可，计划自 2024 年 2 月 8 日起 6 个月内，以其自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额为不低于人民币 300 万元且不超过人民币 500 万元。目前本次增持正在进行当中，将严格按照公告计划实施增持。

未来，公司将继续统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，积极

探索方式方法，在符合相关法律法规及《公司章程》的利润分配政策的前提下，兼顾股东的即期利益和长远利益，实现“持续、稳定、科学”的股东回报机制，提升广大投资者的获得感。

四、加强公司规范运作，提升公司治理水平

1.加强董监高合规培训，强化“关键少数”责任意识

为确保实控人、董事、监事和高级管理人员等“关键少数”了解资本市场相关法律法规，提高董监高的专业素养，筑牢合规意识，公司 2024 年将积极组织公司董事、监事及高级管理人员参加证监会、交易所“浦江大讲堂”及上市公司协会等平台的相关合规培训，确保管理层全部人员及时了解最新法律法规，不断强化“提质增效重回报”意识，提升经营管理水平。同时，公司将持续加强与“关键少数”的沟通交流，跟踪上述相关方的承诺履行情况，不断强化相关方的责任意识和履约意识。公司将督促董事会、监事、高级管理人员及实际控制人等恪守职责，强化自我约束，避免无偿或以不公正的条件向第三方转移利益，不发生任何损害上市公司利益的行为，切实保护上市公司及所有股东的合法权益。

2、优化公司治理结构，提升规范运作水平

公司将在现有内部控制治理体系的基础上，持续规范“三会一层”治理机制，充分发挥股东大会最高权力机构、董事会重大决策、管理层执行、监事会监督，以及专门委员会为董事会重大决策专业把关的作用。规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。同时，公司将进一步明确财务部、合规审计部等各相关部门及人员的职责与权限，审视、修改以及新建相关管理制度，打造一个相互协作、相互监督的内部控制环境。

3、持续完善内控制度建设，强化独立董事监督机制

公司积极响应新修订的《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，及时对《公司章程》《独立董事工作制度》等内控制度进行了修订完善，确立了独立董事专门会议机制。

为加快落实独立董事制度改革，公司将严格按照相关制度要求，通过多项措施为独立董事履行职责提供便利条件，切实保障独立董事的知情权，积极发挥独

立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。各项措施包括但不限于邀请独立董事前往公司总部及各子公司进行现场办公，确保独立董事现场工作时间不少于15日；为独立董事专门会议提供所需的场所和资料；加强审计与独立董事沟通，为独董深度参与公司内审工作提供便利；指定董事会办公室作为独立董事沟通服务部门；及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，强化独立董事对公司的监管体系等。

五、提高信息披露水平，强化投资者沟通，增进市场价值认同

公司一贯坚持以投资者为导向，切实履行信息披露义务，严格遵守信息披露规则，保证信息披露内容的真实、准确、完整、及时，积极维护公司投资者的合法权益。2024年，公司将以投资者需求为导向，结合行业特点优化信息披露内容，高质量开展信息披露相关工作，为股东提供准确的投资决策依据，平等地保护公司、股东，尤其是中小股东的利益。

1、完善多渠道、多形式信息披露。2024年，公司将继续严格遵守法律法规和相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，保持与投资者密切沟通，打造高效透明的沟通平台，主动开展多渠道、高频率的投资者交流，通过定期报告和临时公告、业绩说明会、接待投资者现场调研、上证e互动、电话、邮件等诸多渠道，加强与投资者的沟通和交流，积极向投资者展示公司战略规划、发展状况、经营业绩和投资价值等。公司还将通过一图读懂、图表、图片等形式，借助微信公众号等新媒体传播手段，以更加直观、更加简洁的形式，将公司经营成果、财务状况等内容，多角度、全方位地呈现在投资者面前，减少投资者阅读负担。

2、持续加强投资者关系管理工作。2024年，公司将继续积极参加由上交所组织的业绩说明会和辖区内的投资者网上集体接待日活动，并承诺在年度报告、半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会。此外，公司将通过线上线下等方式，持续接待有调研需求的投资机构、行业分析师、研究员及中小投资者，并邀请现场参观公司的展厅、工厂、生产线和办公区域，使投资者更加全面、直观、近距离地感受公司文化，提高公司在资本市场的开放性，让投资者充分了解公司所处行业、战略规划、业务发展、经营业绩等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定的关系。

六、其他事宜

公司将持续评估《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》的具体举措，致力于通过科学高效的经营管理、规范的公司治理、优良的业绩、积极的投资者回报提升公司投资价值，提高投资者获得感，不负投资者信任。公司将继续专注主营业务，推进长期战略布局，稳步提升公司核心竞争力和可持续发展能力，践行上市公司责任，共同促进资本市场平稳运行。

本次《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》是基于目前公司经营情况和外部环境做出的计划，方案的实施可能受行业发展、经营环境、市场政策等因素的影响，具有一定的不确定性，有关公司规划、发展战略、工作计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

广州方邦电子股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日